欢迎参加**第三代半导体SiC晶体生长及晶圆加工技术研讨会，**参会代表请填写会议回执回传，并在5个工作日内打款至以下账户。参会代表请于**2025年8月20日**携带名片至会场签到并领取资料和参会证，会议及活动期间凭参会证进场，请务必随身佩戴。

**参会费用：**

2800元/人；半导体企业1500/人；学生1500/人；

费用包括：会议资料费、会议餐费、茶歇、会务服务等费用。（付款后开具增值税普通发票）

**付款账户**：

|  |  |
| --- | --- |
| 户名 | 山东中粉网信息技术有限公司 |
| 开户行 | 中国建设银行股份有限公司临沂沂州支行 |
| 帐号 | 37050182640100001790 |

**—————— 会 议 回 执 ————————**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业全称（发票名称） | |  | | | | | |
| 通讯地址 | |  | | | | | |
| 参会意向（选填项） | | □听会  □采购（产品名称 ）  □销售（产品名称 ）  □其它合作需求： | | | | | |
| 参会代表姓名 | | 性别 | 职务 | 联系方式 | | E - MAIL | |
|  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| 会务费用总额  （不含住宿） | | 元整 | | | | ¥ | |
| 如需预定会议酒店住宿请填此项  （报到当天自行办理入住，住宿自费） | 是否预定住宿：  □是 □否 | | | | 住宿标准：  □大床、348元/晚，（早餐58/位）  □标间、348元/晚，（早餐58/位） | | |
| 会议酒店：**白金汉爵大酒店（苏州相城店）**  □ 8月20日（全天报到）  □ 8月21日（全天会议） | | | | | | 地址：苏州市相城区相城大道1111号 |
| **邮箱：d17568086987@163.com**  **联系人：段湾湾**  **联系方式：18610662668/13810445572** | | | | | 签字（盖章）：  日期： | | |